

SCM5307AS

SOP封装压力传感器



产品特点:

- 小尺寸、MEMS技术
- 工作温度:  $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 量程:  $0 \sim 700\text{Kpa}$  (100PSI)
- 线性度: 0.3% (典型值)
- 反面封装设计、防水防潮

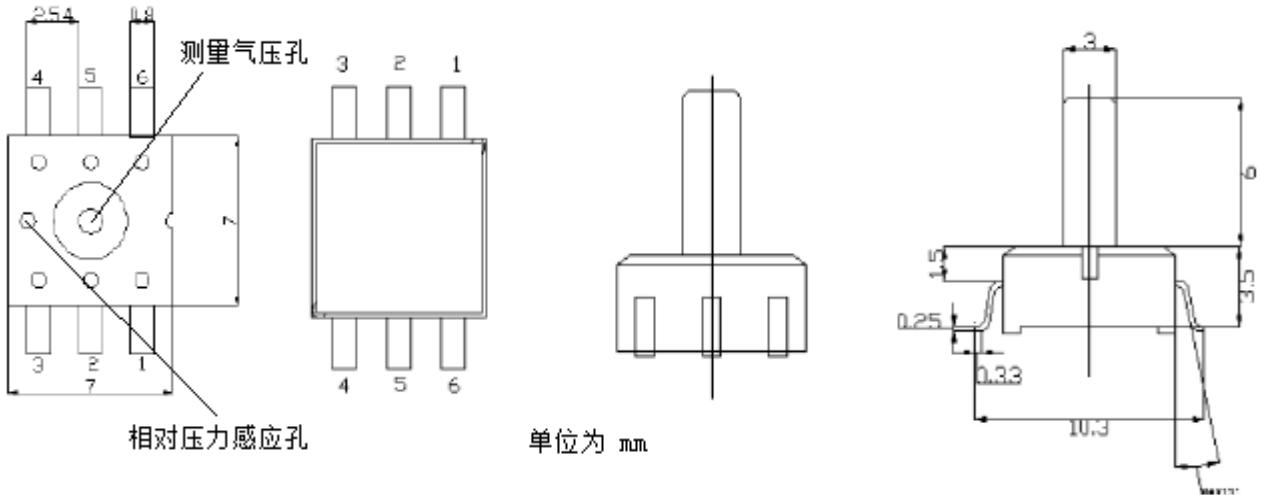
应用领域:

- 消费类电子应用
- 工业/工程控制
- 差压传感器系统
- 医疗系统应用
- 液位控制系统

产品简介

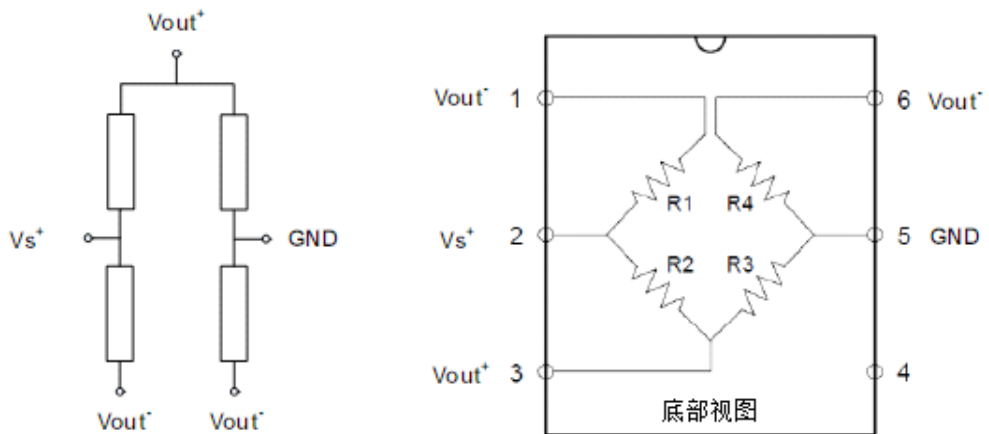
SCM5307是一款SOP模块封装的差压压力传感器,将硅微机械压力传感器芯体反面粘贴在导引管基座的底部,可有效防潮,并采用开环电路设计,可更方便后续电路处理。高度线性的输出电压与所施加的压力成正比,被广泛应用于与气压相关的产品,并具有良好的重复性和长期稳定性。

封装外形:



电路原理

$V_{s+}$ : 驱动电压输入端  
 GND1: 接地端1  
 GND2: 接地端2  
 $V_{out+}$ : 输出正极  
 $V_{out-}$ : 输出负极

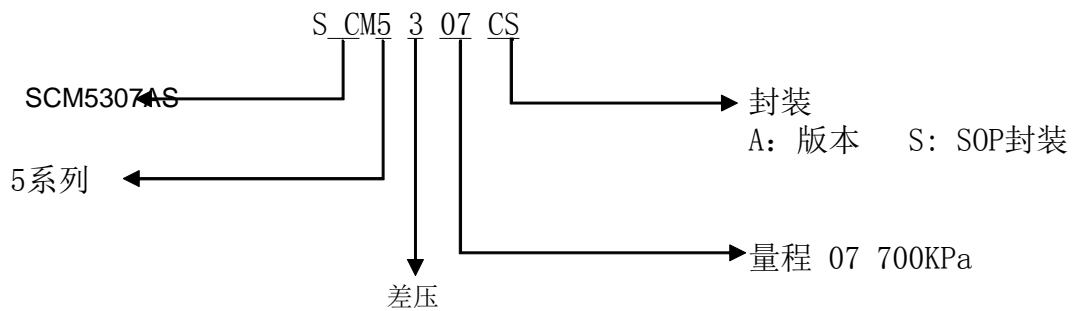


## 性能参数

(芯片工作环境: 驱动电压 $V_{S+}=5VDC$ ; 环境温度  $T_a=25^{\circ}C$ )

参数	最小值	典型值	最大值	单位	
量程	0	-	700	Kpa	
工作温度	-40	-	125	$^{\circ}C$	
桥臂电阻	4.5	5	5.5	k $\Omega$	
零点输出	-20	0	+20	mV	
满量程输出	80	100	120	mV	
线性度	0.1	0.2	0.3	%FS	
温度系数	电阻	2000	2200	2500	ppm/ $^{\circ}C$
	灵敏度	-2000	-2200	-2500	ppm/ $^{\circ}C$
	零点漂移	-60	-	60	$\mu V/^{\circ}C$
压力迟滞	-	-	0.2	%FS	
重复性	-	-	0.2	%FS	
温度迟滞	-	-	0.2	%FS	
驱动电压	-	5	10	V	
储存温度	-40	-	150	$^{\circ}C$	
压力过载			3X		

## 订购信息



## 联系方式